

2016年3月期 第1四半期 (2015年4月～6月)

東京エレクトロン 決算説明会

内容：

- 挨拶 代表取締役社長、CEO 東 哲郎
- 第1四半期連結決算の概要 取締役常務執行役員 堀 哲朗
- 事業環境および業績予想修正 代表取締役副社長、COO 河合 利樹

2015年7月28日

第1四半期連結決算の概要

取締役常務執行役員 堀 哲朗

2015年7月28日

2016年3月期 第1四半期のハイライト

1. 中期経営計画を発表
新たな株主還元策により、配当性向を50%に向上
2. 売上総利益率42%、営業利益率19%を達成
3. 市場調整をおり込み、業績予想を修正

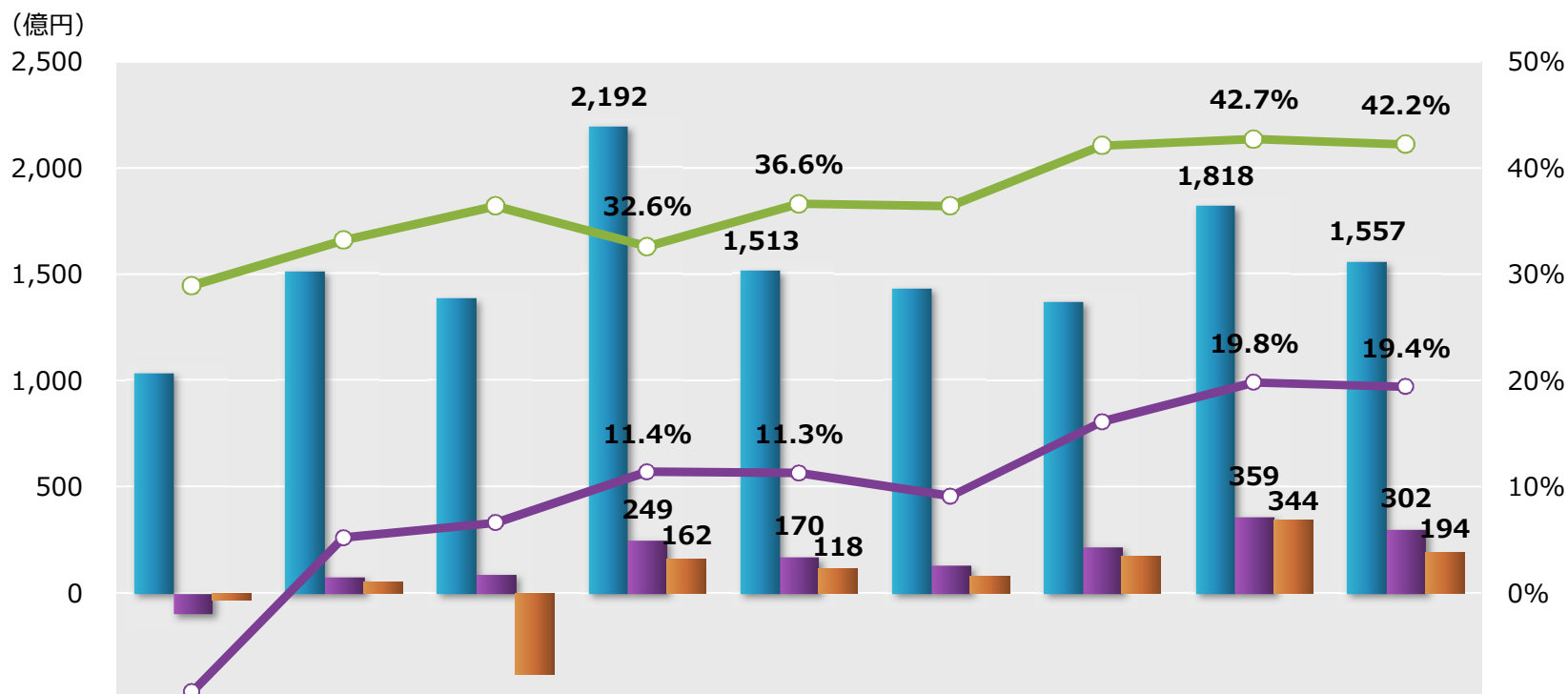
損益状況

(億円)

	2015年3月期				2016年3月期	対前年 1Q増減
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
売上高	1,513	1,429	1,370	1,818	1,557	+2.9%
売上総利益 下段：売上総利益率	553 36.6%	520 36.4%	576 42.1%	776 42.7%	657 42.2%	+18.6% +5.6pts
販管費	383	390	355	417	354	-7.5%
営業利益 下段：営業利益率	170 11.3%	130 9.1%	220 16.1%	359 19.8%	302 19.4%	+132 +8.1pts
税前利益	150	140	247	329	290	+140
親会社株主に帰属 する当期純利益	118	81	174	344	194	+76
研究開発費	167	181	168	195	175	+4.9%
設備投資額	37	35	26	32	21	-41.9%
減価償却実施額	47	50	54	56	46	-2.0%

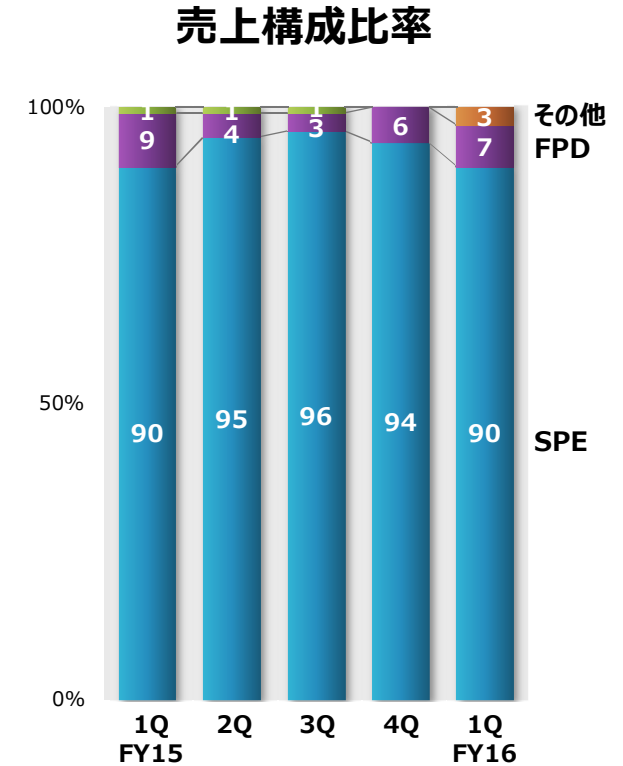
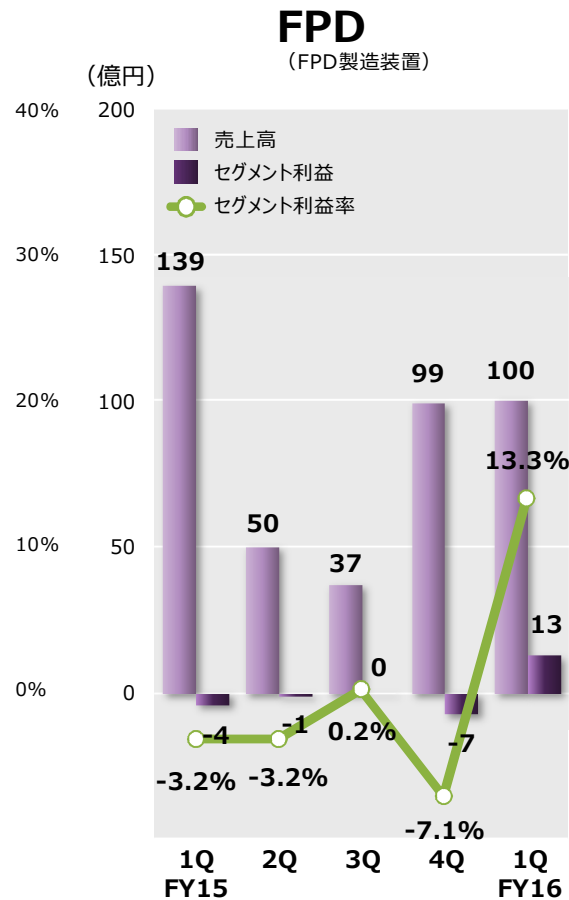
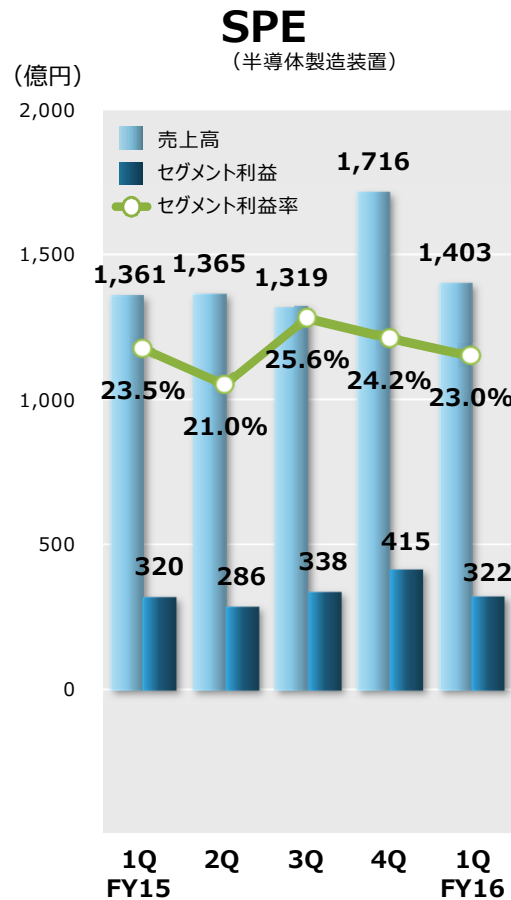
1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況



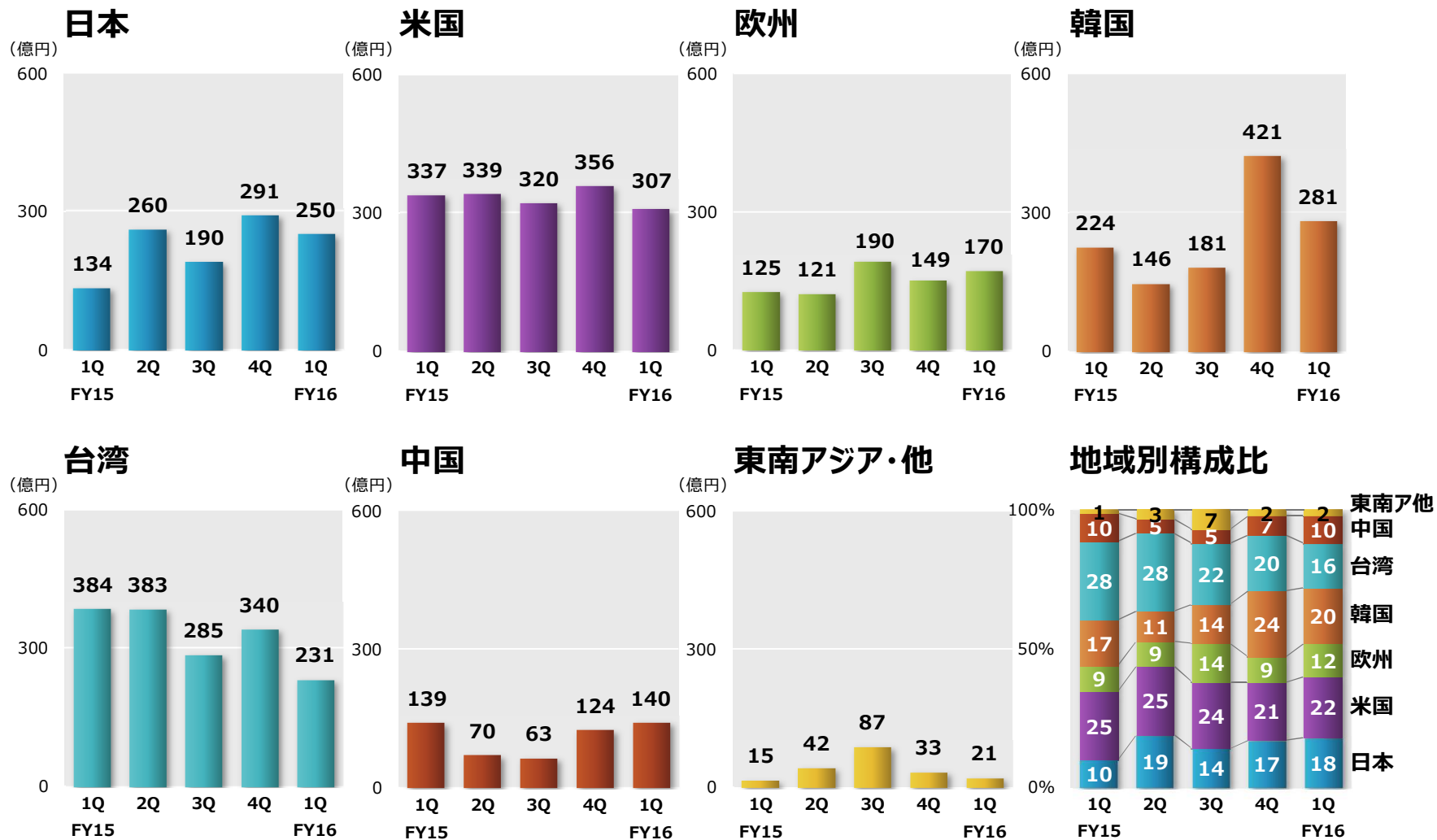
	1Q FY14	2Q	3Q	4Q	1Q FY15	2Q	3Q	4Q	1Q FY16
売上高	1,034	1,510	1,384	2,192	1,513	1,429	1,370	1,818	1,557
営業利益	-96	78	90	249	170	130	220	359	302
親会社株主に帰属する当期純利益	-29	54	-380	162	118	81	174	344	194
売上総利益率	28.9%	33.2%	36.4%	32.6%	36.6%	36.4%	42.1%	42.7%	42.2%
営業利益率	-9.3%	5.2%	6.6%	11.4%	11.3%	9.1%	16.1%	19.8%	19.4%

セグメント情報



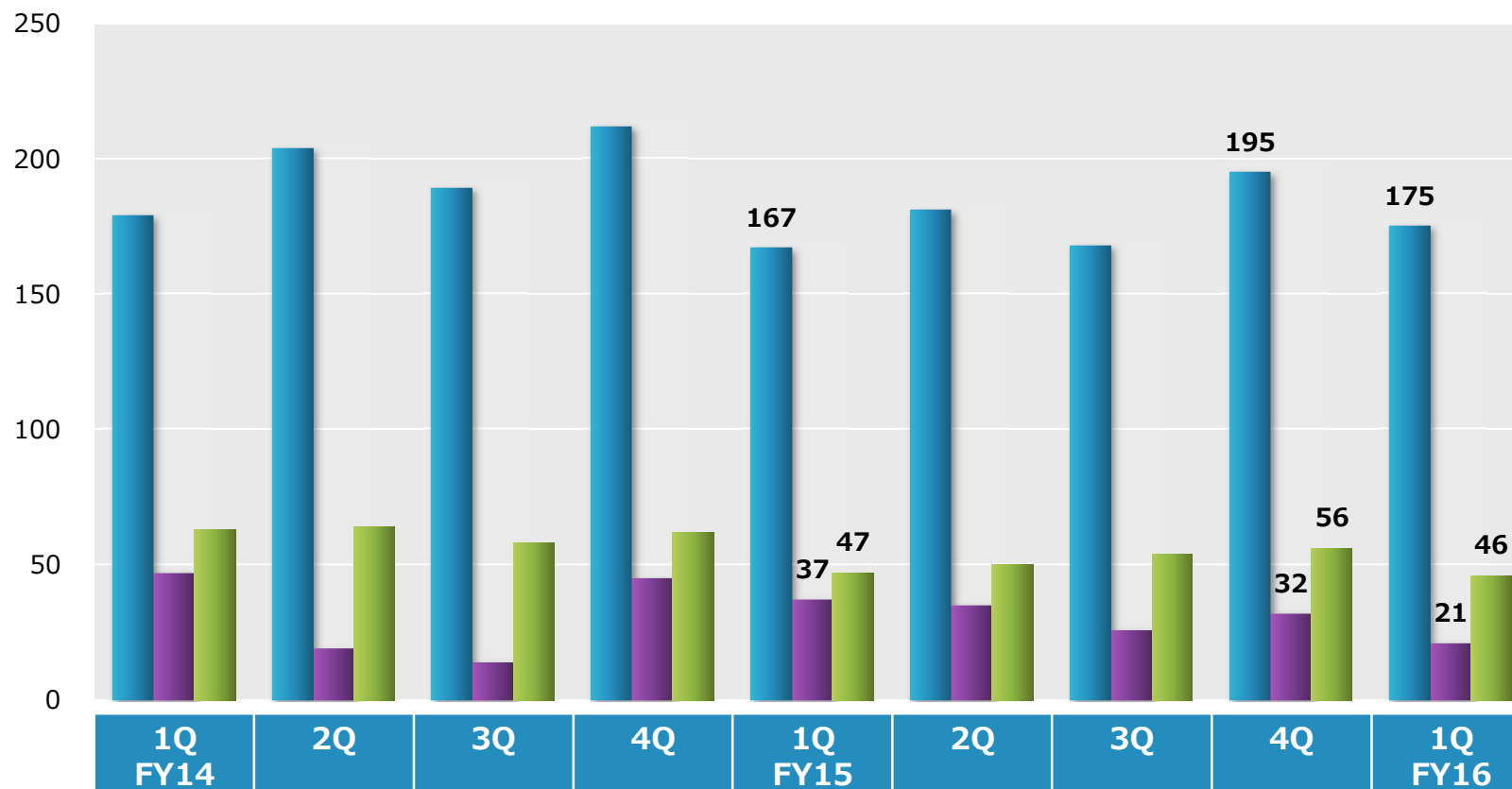
1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. FY16/1Qより、PV製造装置事業については、重要性が低下したため、報告セグメントから除外しました。

SPE部門地域別売上高



研究開発費・設備投資額・減価償却実施額

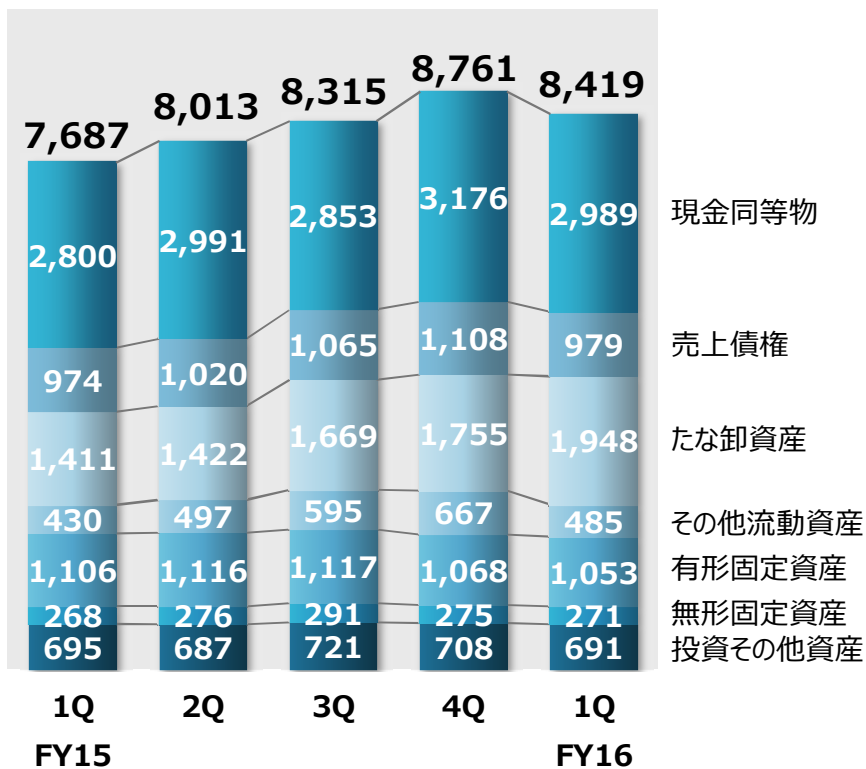
(億円)



貸借対照表

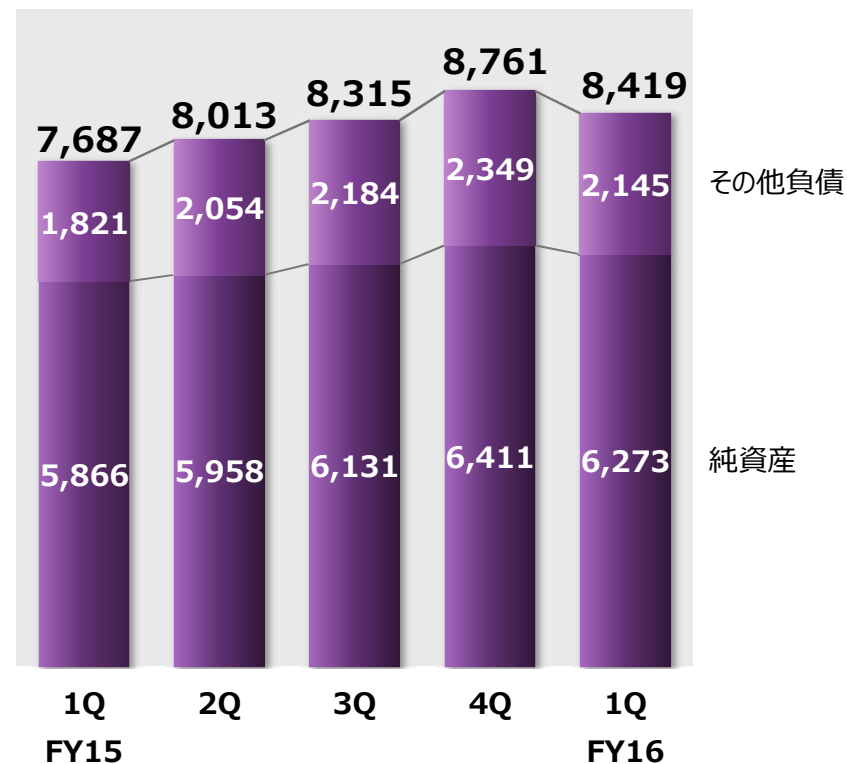
資産

(億円)



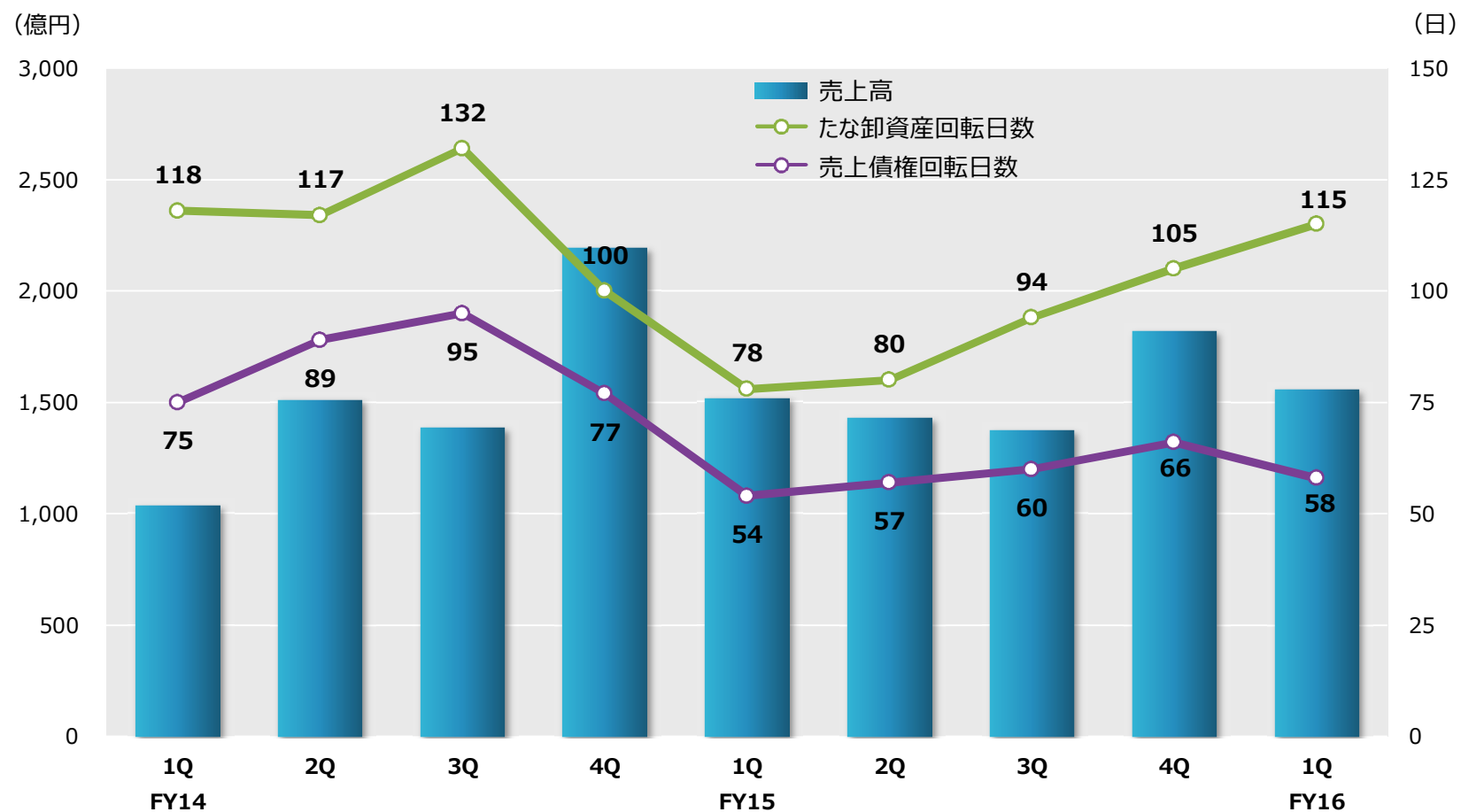
負債・純資産

(億円)



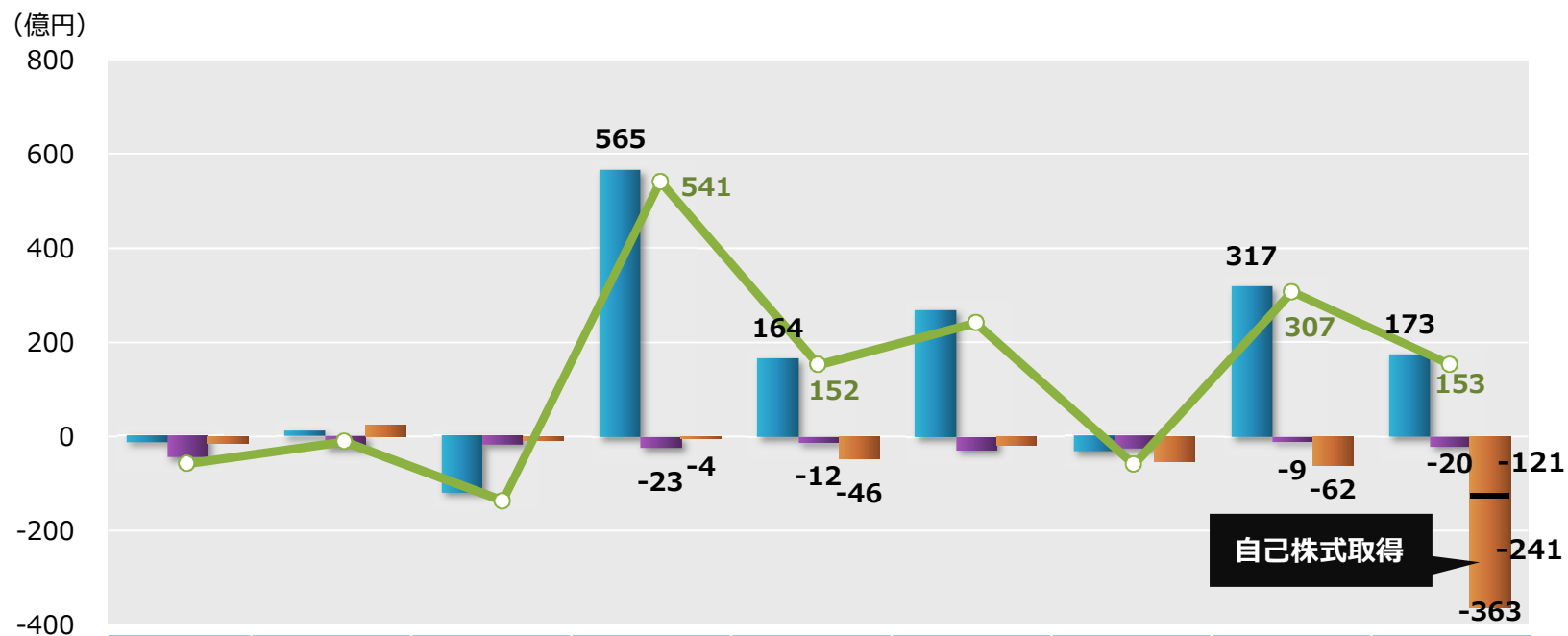
現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は「有価証券」）

たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー



	1Q FY14	2Q	3Q	4Q	1Q FY15	2Q	3Q	4Q	1Q FY16
営業キャッシュフロー	-13	11	-118	565	164	268	-32	317	173
投資キャッシュフロー*	-44	-23	-18	-23	-12	-27	-26	-9	-20
財務キャッシュフロー	-14	25	-8	-4	-46	-18	-54	-62	-363
フリーキャッシュフロー**	-58	-11	-137	541	152	241	-59	307	153
手元資金残高***	2,295	2,308	2,125	2,681	2,800	2,991	2,853	3,176	2,989

*投資キャッシュフローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

**フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー（満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く）

***手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

自己株式取得の進捗状況

取得した自己株式の累計 (2015年6月30日現在)

- (1) 株式の総数 3,111,900株
- (2) 株式の取得価額の総額 23,838,423,989円

2015年4月27日発表内容

- 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 : 1,540万株 (上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.59%)
- 株式の取得価額の総額 : 1,200 億円 (上限)
- 取得する期間 : 2015年5月14日～2016年5月13日

事業環境および業績予想修正

代表取締役副社長、COO 河合 利樹

2015年7月28日



TOKYO ELECTRON

CORP IR/July 28, 2015

事業環境

▶ 半導体設備投資

CY2015の半導体前工程（WFE）の設備投資額は、企業向けサーバ市場およびモバイル需要に牽引され、前年比微増を見込む。

- DRAM/NAND：増産投資により前年比増加
- ファウンドリ：1X世代先端ロジック向け投資が継続
- ロジック：サーバ・イメージセンサ向けが好調である一方、PC需要が弱含み、ロジック全体としては前年比減少

▶ FPD設備投資

CY2015の液晶パネル用製造装置の需要は、大型パネル向け設備投資の増加に加えて、モバイル用途の中小型パネル向けの投資も開始され、前年比20%の増加を見込む。有機ELテレビ市場の立ち上がりは2017年以降。

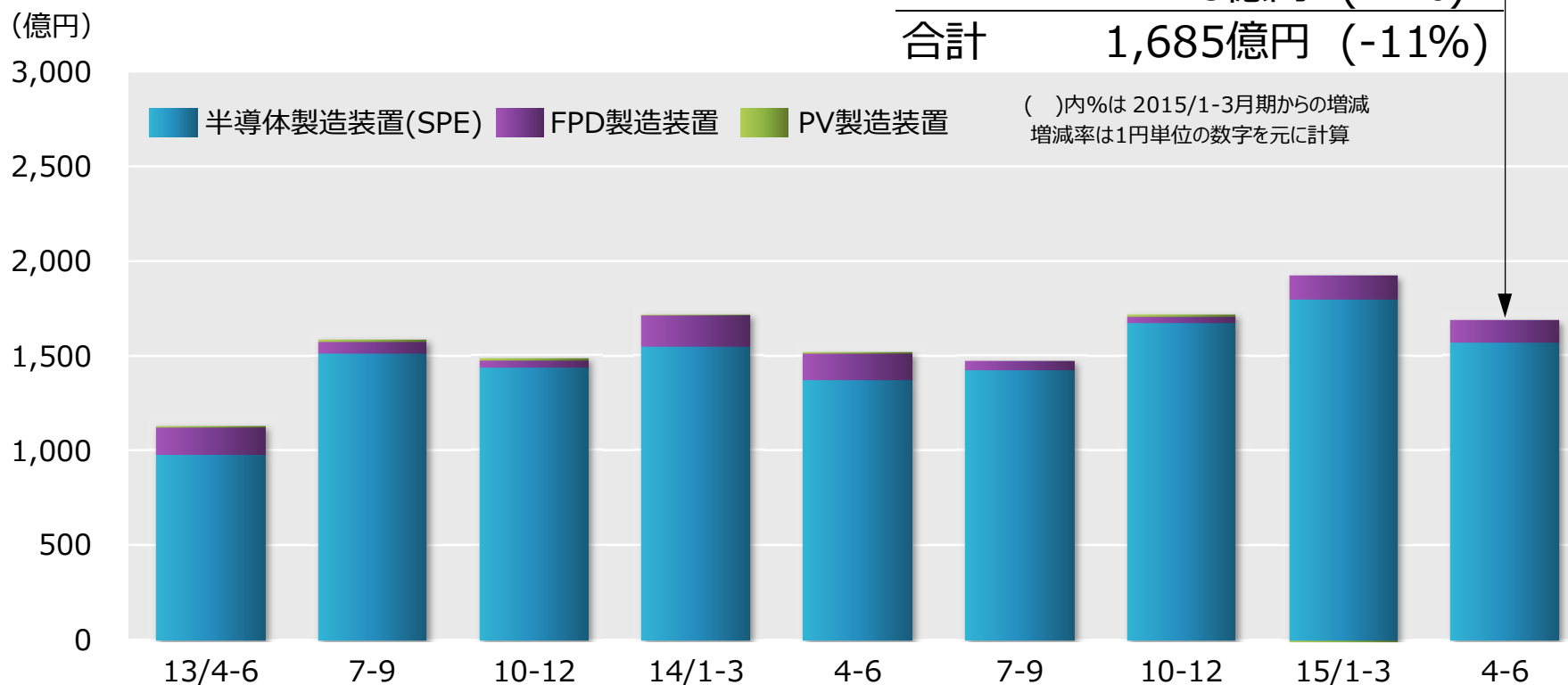
(2015年7月時点での見方)

半導体の製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組み立て・検査をする後工程があります。WFE（Wafer Fab Equipment）は、この前工程で使用される製造装置を示します。

四半期 受注額

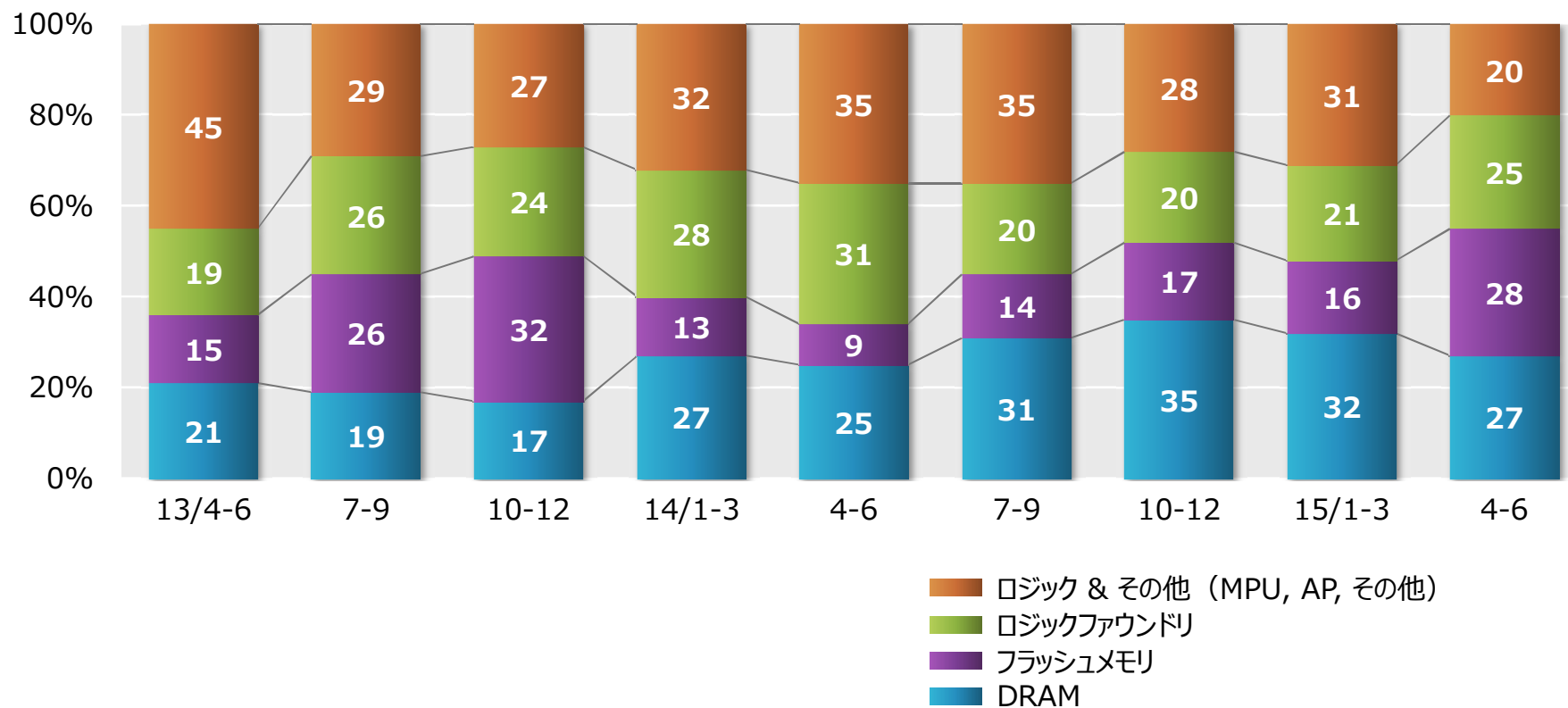
2015/4-6月期

SPE	1,566億円 (-13%)
FPD	118億円 (-7%)
合計	1,685億円 (-11%)



2015/4-6月期より、PV製造装置事業については、重要性が低下したため、報告セグメントから除外しました。
これにより、受注額についても非開示としています。

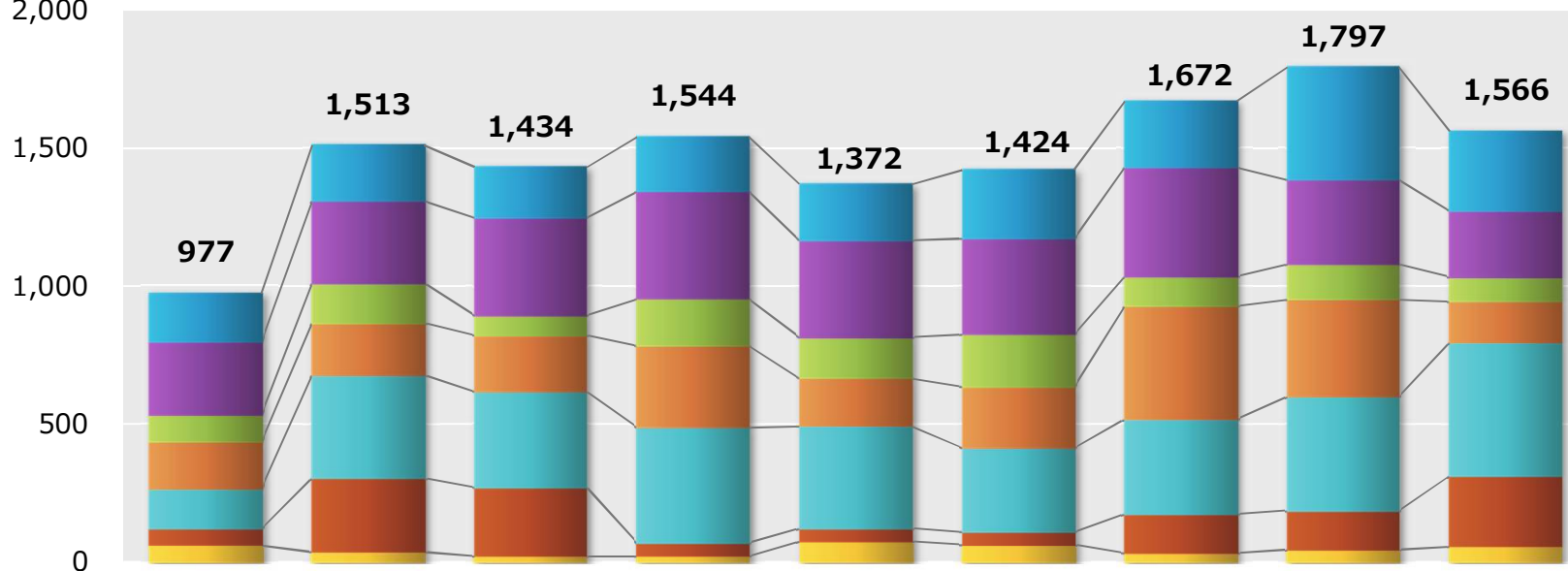
SPE受注アプリケーション別構成比



グラフは装置本体受注額における構成比を示しています。

地域別SPE受注額

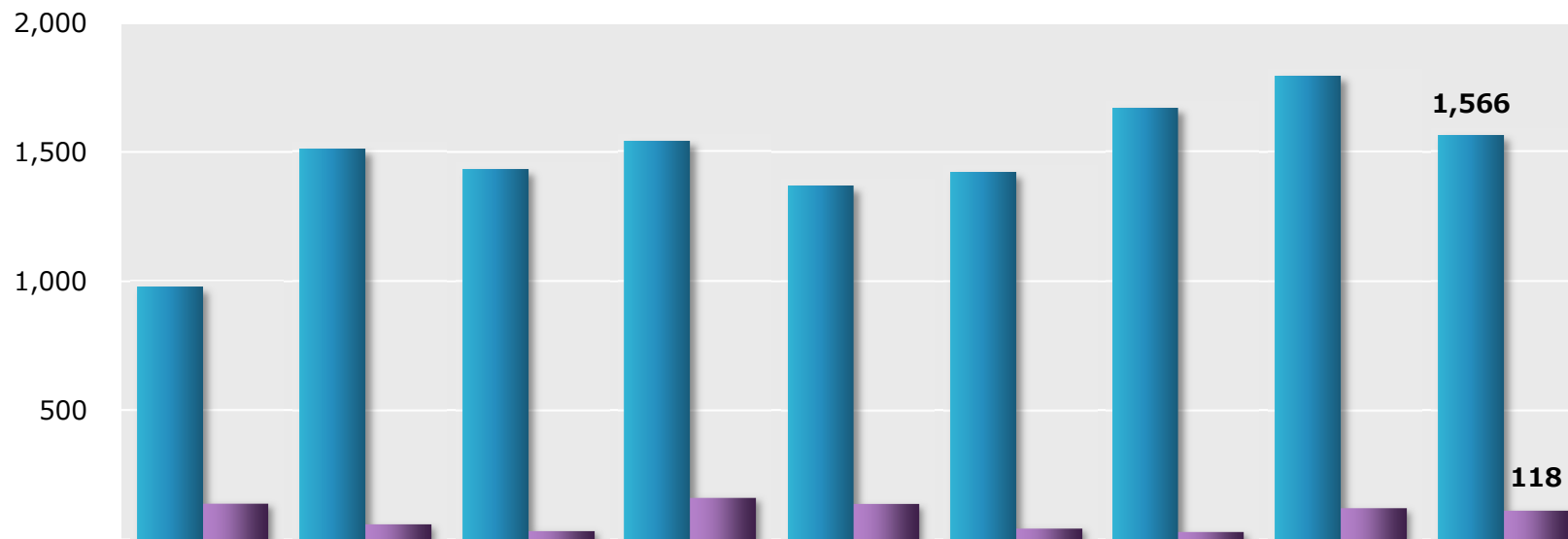
(億円)
2,000



	13/4-6	7-9	10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6
■ 国内	175	201	184	198	204	249	240	408	290
■ 米国	264	298	353	389	351	347	395	307	239
■ 欧州	98	144	72	170	150	190	108	127	89
■ 韓国	170	189	205	295	173	221	408	351	148
■ 台湾	144	373	346	418	370	305	345	413	483
■ 中国	62	269	249	48	47	45	142	142	257
■ 東南アジア・他	60	36	22	22	75	64	32	45	56

受注額・受注残高

(億円)



	13/4-6	7-9	10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6
SPE受注額	977	1,513	1,434	1,544	1,372	1,424	1,672	1,797	1,566
FPD受注額	144	63	38	166	142	48	34	126	118
SPE受注残高	1,645	1,960	2,372	2,099	2,110	2,170	2,523	2,604	2,767
FPD受注残高	255	274	225	290	293	291	288	316	333

2015/4-6月期より、PV製造装置事業については、重要性が低下したため、報告セグメントから除外しました。
これにより、受注額、受注残高についても非開示としています。

2016年3月期 業績予想修正

2016年3月期 業績予想修正

➤ 市場調整をおり込み、業績予想を修正

(億円)

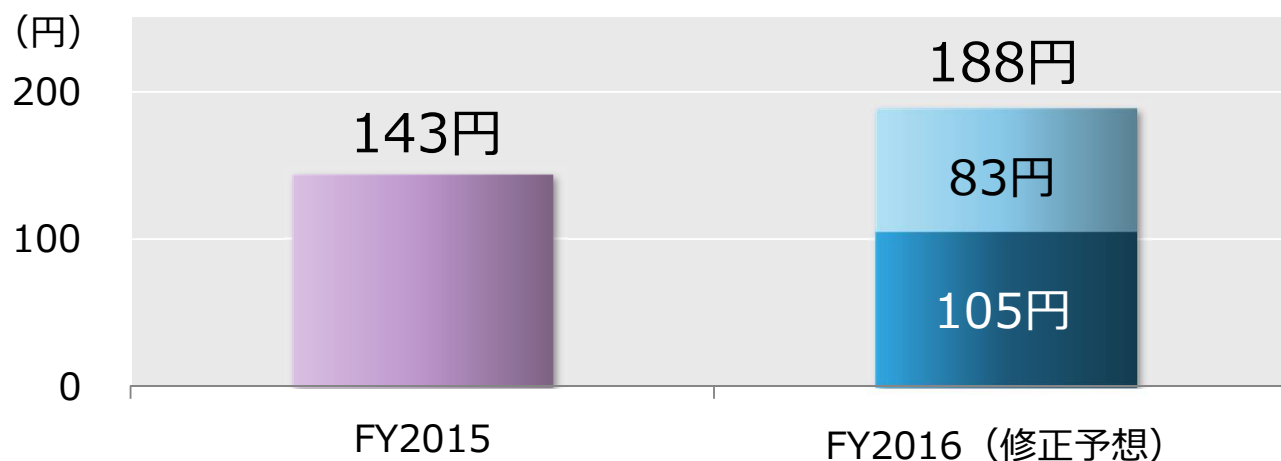
	FY2015 (実績)	FY2016 (予想)						通期 対前年 増減
		上期		下期		通期		
		新予想	修正額*	新予想	修正額*	新予想	修正額*	
売上高	6,131	3,385	+185	3,065	-485	6,450	-300	+5%
SPE	5,762	3,150	+150	2,790	-460	5,940	-310	+3%
FPD	327	180	+5	270	-25	450	-20	+38%
営業利益	881	535	+65	415	-235	950	-170	+69
下段：営業利益率	14.4%	15.8%	+1.1pts	13.5%	-4.8pts	14.7%	-1.9pts	+0.3pts
税前利益	868	525	+65	415	-235	940	-170	+72
親会社株主に帰属 する当期純利益	718	370	+40	290	-170	660	-130	-58

*修正額：2015/4/27に発表した業績予想からの修正額を示しています。SPE：半導体製造装置 FPD：フラットパネルディスプレイ製造装置

2016年3月期 配当予想

- 新しい株主還元策として、配当性向を50%に引き上げ、188円の高配当を予定

1株当たり配当金（予想）		
中間配当	期末配当	合計
105円	83円	188円



従来の配当政策は、FY2011の期末配当より連結配当性向を35%目途としておりました。

中期経営計画のハイライト



TOKYO ELECTRON

CORP IR/July 28, 2015

中期経営計画の財務モデル（2020年3月期までに達成）

➤ 目指すのは、グローバル水準の収益力

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	
	WFE \$33B	WFE \$30B	WFE \$37B
売上高	6,450	7,200	9,000
売上総利益率	38%	42%	44%
販管費 <small>売上高販管費比率</small>	1,490 23%	1,600 22%	1,700 19%
営業利益率	15%	20%	25%
ROE		15%	20%

半導体の製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組み立て・検査をする後工程があります。
WFE（Wafer Fab Equipment）は、この前工程で使用される製造装置を示します。

中期経営計画の基本戦略

1. 市場成長をアウトパフォーム

- SPEの成長分野であるエッチング・ALD・洗浄事業に注力
- フィールドソリューション事業の拡充

2. オペレーションの効率化

- 開発・製造の効率を高める
- 売上高販管費比率の低減



**高付加価値の製品投入でシェア拡大と収益性向上
売上拡大に対するコストの増加を抑制**

中長期の市場展望

1. IoTが半導体用途を広げ、半導体市場が拡大
2. 技術変換点を迎え、多岐にわたる新技術が半導体の進化を支える
 - 先端パターニング技術
 - デバイスの3D化、新材料、新構造
 - 新メモリ（STT-MRAM）

中長期的にWFE市場の拡大を見込む

IoT: Internet of Things (モノのインターネット)

STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory

中期計画メインシナリオ（WFE \$37Bケース）

売上高 9,000億円（40%拡大）

売上総利益率 44%（6pts向上）

販管費比率 19%（4pts低減）

営業利益率25%（10pts向上）

各目標値にあるカッコ内の数字は、FY2016の業績予想との比較です。

▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

